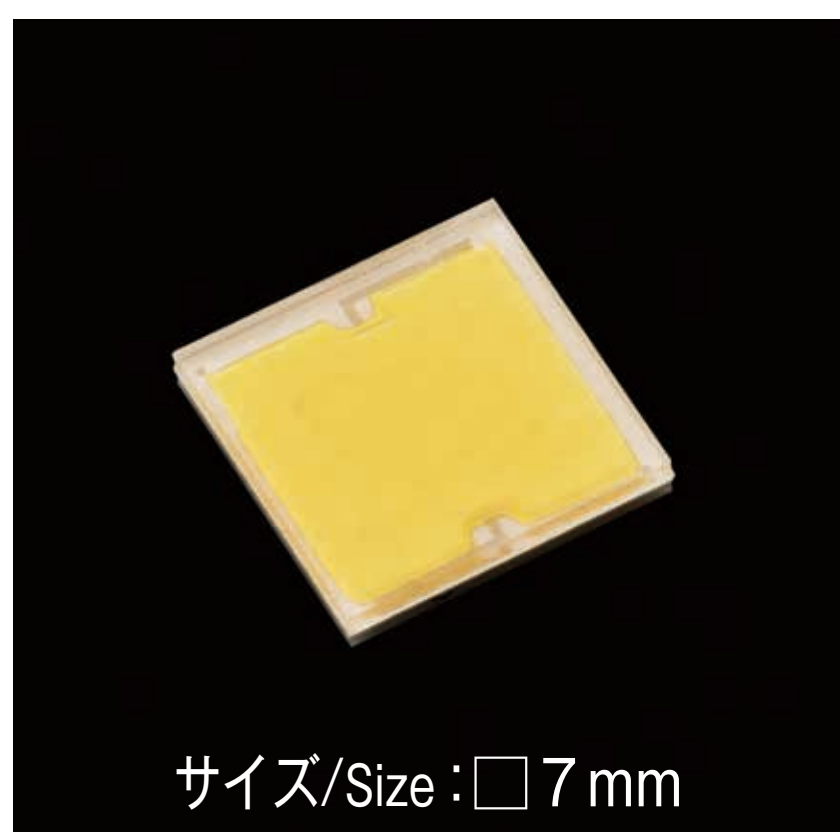


超小型COB

Ultra-small COB

一般光
Standard white

太陽光
Sunlight type



サイズ/Size : □7mm

FC-COBパッケージ / FC-COBpackage

WHITE Hi

Pb Free

Pb Free HEAT

RoHS

- ・ FlipChipを採用し、超小型・大光束を達成
Achieved high luminous flux in an ultra-small size by using Flip Chip
- ・ リフロー実装対応で取扱い利便性向上
More convenient handling with reflow mounting compatibility

製品ラインナップ / Products lineup

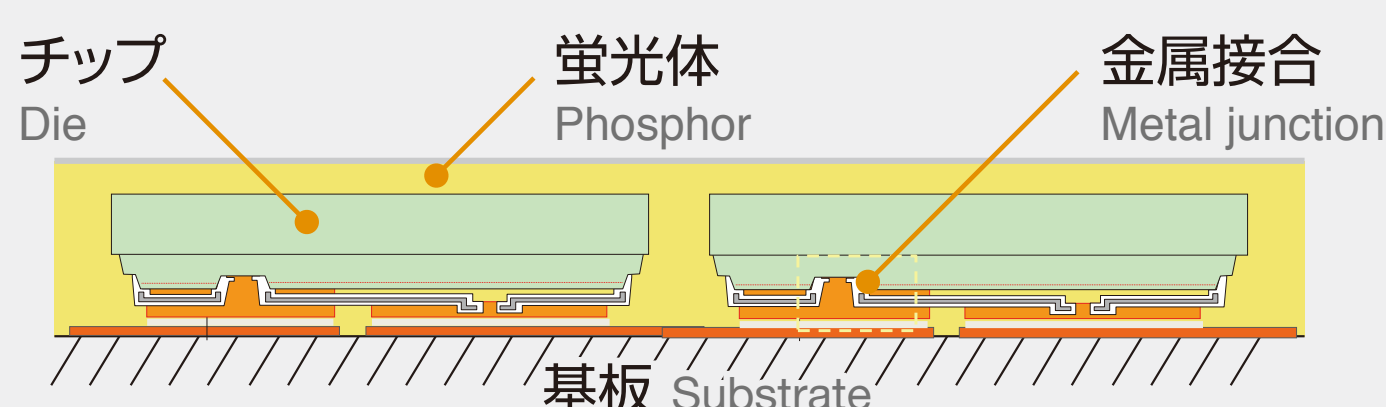
| | 光束 Luminous Flux | 電力 Wattage | 効率 Efficacy | 順電流 Forward current | 順電圧 Forward voltage | 色温度 Color temperature | Ra |
|-----------------------|---------------------|---------------|----------------|------------------------|------------------------|--------------------------|----|
| 一般光 Standard white | 2200 lm | 16.3 W | 135 lm/W | 500 mA | 32.5 V | 6500 K | 80 |
| | 1790 lm | 16.3 W | 110 lm/W | 500 mA | 32.5 V | 2700 K | 80 |
| 太陽光 Sunlight type | 1100 lm | 16.8 W | 65 lm/W | 500 mA | 33.5 V | 6500 K | 98 |
| | 1040 lm | 16.8 W | 60 lm/W | 500 mA | 33.5 V | 2700 K | 98 |

Tj=85°C

金属接合(基板直付)による
With metal junction (directly mounted to substrate)

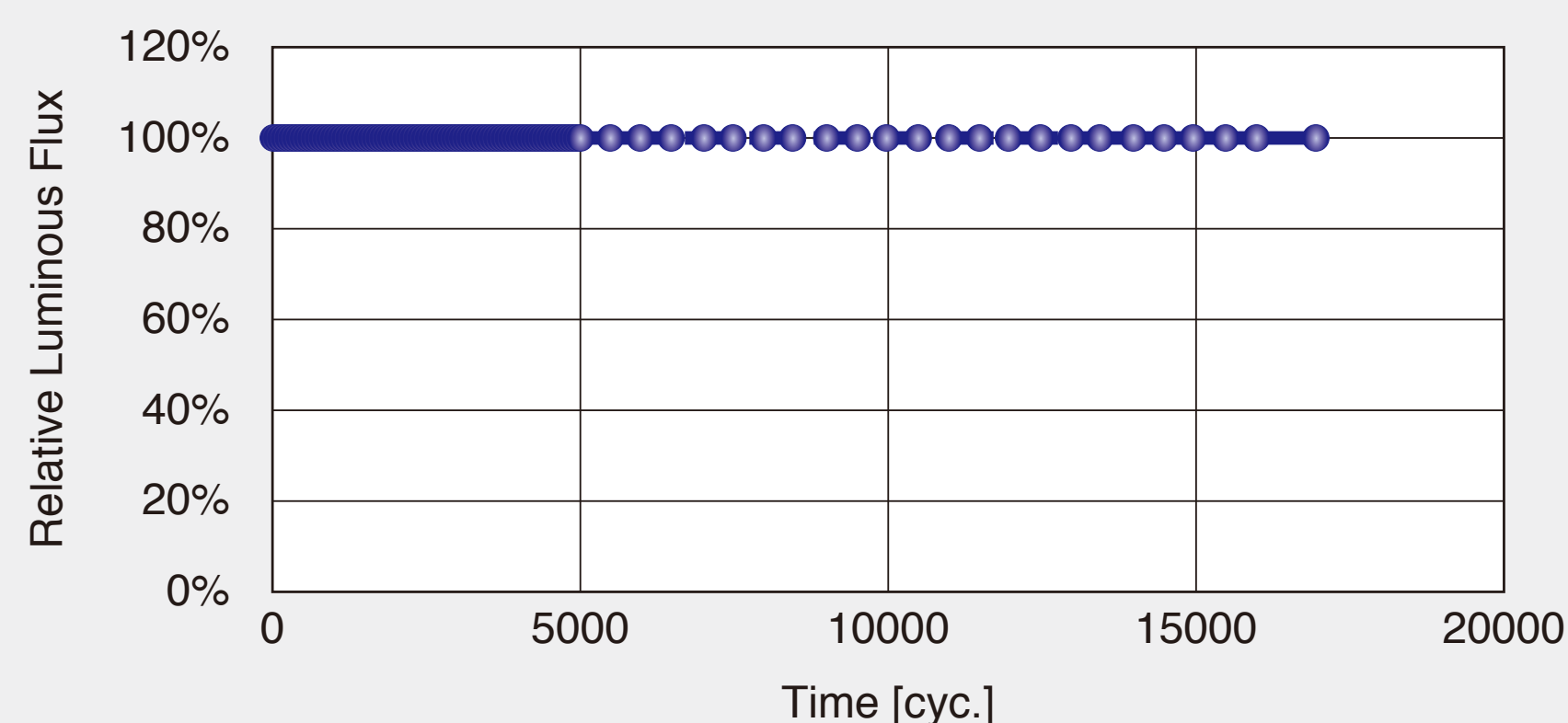
高信頼性
High reliability

当社標準に対し5倍以上の信頼性確保
Ensures reliability at least 5 times greater than in-house standards



フリップチップ断面図
Flip chip cross-section

熱衝撃試験 <試験条件> -40°C(5min.) ⇄ 100°C(5min.)
Thermal shock test (test conditions: -40°C (5 min) ⇄ 100°C (5 min))



材料と構造設計の見直しによる
With reconsideration of materials and structural design

長寿命
Long life

放熱対策と耐クラック性アップ
Improved heat dissipation measures and crack resistance



従来品
Conventional product

開発品
New product

高温動作試験 <試験条件> IF=350mA@チップ Tj=133°C
High Temperature operating test (test conditions: IF = 350 mA @ die, Tj = 133°C)

